

# 대학·연구소·산업체 연구자 1,000여명 참가 '성황'

올해로 12회째를 맞은 한국반도체학술대회에는 모바일 융합시대에 적합한 반도체 기술 관련 논문을 비롯해 300mm 웨이퍼 성숙기 진입을 위한 기초 기술, 나노반도체 관련 기술 논문이 주를 이뤘다. 국내 유일의 반도체 학회인 한국반도체학술대회가 '모바일 융합 반도체(Semiconductor as enabler for Mobile Convergence)'를 주제로 지난달 24일 삼성동 코엑스에서 개막했다.

클\_권경희 기자

**제** 12회 한국반도체 학술대회가 1,000여명의 반도체 관련 업계, 학계, 연구계 관계자들이 참석한 가운데 서울 코엑스 컨퍼런스센터에서 이를 일정으로 지난달 24일 개최됐다.

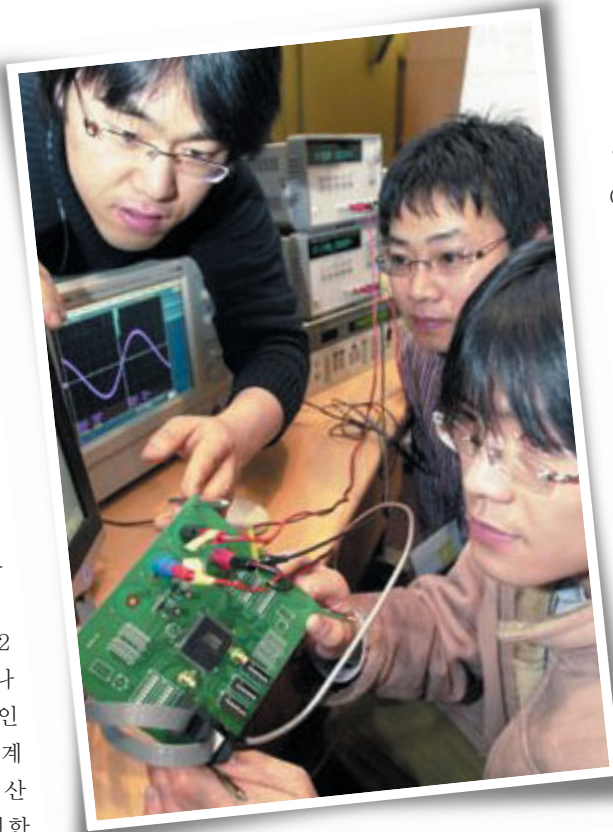
'Semiconductor as enabler for Mobile Convergence(모바일 융합을 가능케 하는 반도체)'라는 테마로 하이닉스반도체와 한국반도체산업협회가 주관한 이번 학술대회에는 당초 기대보다 많은 대학과 연구소, 산업체 연구자 1,000여명이 참석해 성황을 이뤘다.

오후 1시부터 진행된 개막식에서 제12회 한국반도체학술대회회장인 허엽 매그나칩반도체 사장은 '우리 경제의 성장엔진인 반도체 산업은 외국의 전문기관, 학계, 업계에서도 본받는 모범산업으로 우리나라의 산업과 경제의 근간을 이루고 있다'며 '이번 한국반도체학술대회를 통해 국내 반도체산업의 도약 방안을 심도있게 나누고자 한다'고 인사말을 했다.

이어 과기부 유비쿼터스 컴퓨팅 프런티어 사업단장 조위덕 박사가 유비쿼터스 컴퓨팅 온칩(Uoc)의 기술과 개발전략을 발표했으며, ST마이크로 파올로 카펠레티 부사장이 모바일컴퓨팅을 가능케하는 반도체 기술을 주제로 강연했다. 이어 오후 6시부터 오명 부총리 겸 과학기술부장관이 '과학기술 중심사회 구축'을 주제로 기조연설을 진행했다.

이날 학술대회장 3층에서 열린 칩 디자인 콘테스트에는 약 100개팀의 학생 및 연구원들이 자신들이 연구한 과제를 전시하고, 이에 대해 열린 토론회를 진행해 관심을 모았다.

특히 서울대 전기공학부 최우영씨(박사과정 3년차)팀의 논문인



'Fabrication of a 100nm N-Channel I-MOS and it's electrical Characteristics'를 두고는 콘테스트를 지켜보던 다른 학생 및 기업 연구원들간에 즉석 토론이 벌어지기도 했다.

이 논문은 기존 반도체의 회로 동작방식(드레인 n, 소스 n)과 달리 소스에 마이너스 전하를 거는 방식(드레인 n, 소스 p)으로 반도체의 전기적 특성을 개선할 뿐만 아니라 기존에 4번의 마스크 공정이 필요하던 것을 한번에 처리할 수 있게 한 내용이다.

이 자리에는 KAIST, 이화여대의 학생과 삼성전자, 매그나칩의 연구원들이 모여 이 같은 I-MOS 방식의 장단점을 논의하는 등 열린 토론이 진행

돼 행사의 열기를 더했다.

이날 학술대회에선 당일 진행된 칩 디자인 콘테스트에서 많은 호응을 받은 논문에 대한 시상식과 자일링스상, 알테라상 등이 수여됐다. 우수논문상(장문규-ETRI, 김대형-서울대, 송남진-서강대, 장윤경-삼성전자)과 우수포스터상(김영우-한양대, 조일환-서울대), 삼성상(김진봉-KAIST), 하이닉스상(권오성-서울대) 등이 전달됐다. 또 11회 학술대회회장을 맡았던 전북대 이형재 교수와 제 12회 분과위원장 그룹장을 맡은 서울대 윤의준 교수와 포항공대 정진용교수에게 각각 감사패가 전달됐다.

이틀째인 25일에는 윤의준교수의 '우리나라 화합물 반도체 산업의 미래'와 KAIST 김정호 교수의 SiP/SoP 기술의 경쟁력과 성공적인 시장 진입전략 등의 세션이 진행됐다. ●